

手机芯片市场洗牌后的新排名预测

博主



博客名称:舍瓦 V
日志总数:168
评论数量:660
访问次数:296001
建立时间:2011-1-26 17:59

加好友 发纸条

作为一个手机芯片市场上混了N年的软硅工，谈谈我对手机芯片市场的看法：

这几年手机芯片市场作为整个芯片市场中发展最快的方向，好多公司进进出出，城头变幻大王旗，每年都有新公司进来，还有很多老公司退出。最近几年竞争激烈，每年几乎一家大厂退出这个领域，从一开始的ADI，TI，到今年的STE，Renesas……

还在江湖上混的就只有QCOM高通，BRCM博通，INTC英特尔，MTK联发科，NVDA英伟达，MRVL美满，SPRD展讯，RDA锐迪科（上市股P代码）

联芯，VIA等厂商太小不算，全志，瑞芯微等不在手机市场上（pad）。

今年一个重要的变化是手机开始变成commodity，并且出货量增长速度变慢，

1. 高端手机没有新的突破，iphone，galaxy 4的销量没有那么火爆。
2. 中国的中高端手机开始占领大量市场，中华酷联米 5家公司出货量显著增加。
3. 低端智能手机开始代替功能机大量出货，很多运营商开始打低价贴牌手机代替功能机。比如中移动，中国联通推出500元左右的智能机。这个导致整个智能手机的平均ASP往下降。
4. 手机/pad之间界限模糊，很多7寸带通讯功能的pad今后会大卖。

以上几个因素会大大改变现有的竞争格局：以下是我个人理解的排名：

1. QCOM，凭借高端AP，强大BP，唯一的LTE，在去年和今年得到大量出货量。

但是随着今年开始ASP下降，QCOM收得license fee会慢慢下降。高端手机里面，只能**P给apple，三星美国以外市场也没用QCOM AP。中低端市场，MTK越战越勇，抢了无数单子，QCOM QRD整体成本跟support还是不能跟MTK TurnKey较量。

MTK推出8核进入高端市场会更加威胁QCOM高端SoC销量。

LTE今年开始会有别的公司进入，明年几乎所有公司都会进入，QCOM的壁垒一点一点被攻破。